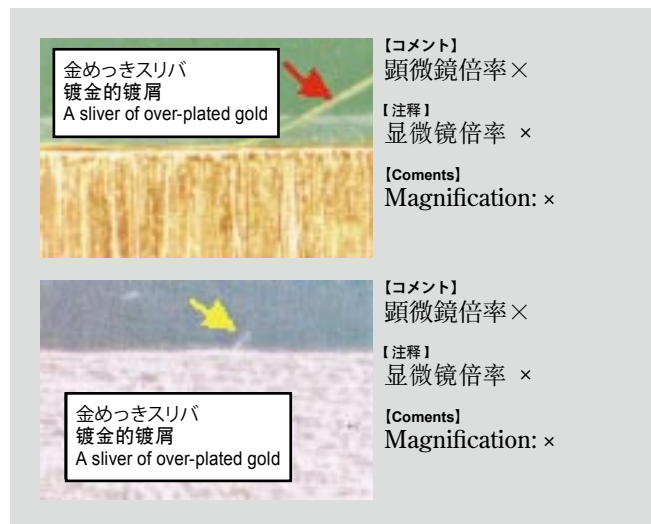


【原因、判断要点、发生工序】在 ET 剂的焊料或者镀金层的镀层突沿有针形细片的模样，即将从导线边缘剥落所引起的。如果导线 ET 过度，就容易产生(ET 工序、表面处理工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

An overhang after etching of solder or over-plated gold used as for metal etching resist is partially separated in the form of a fine needle from the edge of a conductor. The defect is likely to occur, when conductive pattern is over-etched. (Etching - surface finishing process)



1-5-3-4 レーザ穴突起／激光孔的凸出 / Projected conductor from laser drilled hole

【特徴】 ブラインドスルーホール底の部分が破れたような形状で銅めっきが飛び出している突起

【特征】 盲孔底の局部破裂，镀铜层鼓起的凸出。

【Characteristics】 Plated copper plating is projected downward from the bottom of a blind through hole, as if the bottom is ruptured.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ビア下ランドとスルーホールの相対位置がずれたことによりレーザー穴がビア下ランドからはみ出したため、その部分に銅めっきが析出して出来たもの（ビルドアップ積層工程、レーザー穴明け工程、スルーホールめっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 由于导通孔下边的焊环与通孔的相对位置偏移，激光孔超出导通孔下边的焊环，在该部位沉积铜所引起的（积层层压工序、激光钻孔工序、镀通孔工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Imperfect registration of drilled hole to via-bottom land causes the laser drilled hole to pierce the via-bottom land. Copper is deposited at this spot to form a projection. (Build-up lamination, laser drilling and through hole plating process)

